

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-023

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 311496558 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
传真	021-57850620	021-57850620	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司业务及产品

公司始终坚持自主研发，持续进行技术创新，经过二十多年发展，主要形成两大类业务，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。主要产品包括：

（1）晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品

晶圆制造及先进封装用电镀液和添加剂系列产品为公司面向芯片制造领域开发的第二代电子电镀产品。主要包括大马士革铜互连、TSV、Bumping 电镀液及配套添加剂。

（2）晶圆制造用清洗液系列产品

晶圆制造用蚀刻后清洗液以及研磨后清洗液系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子清洗液系列产品。主要包括铜制程蚀刻后清洗液、铝制程蚀刻后清洗液、化学机械研磨后清洗液等。

（3）集成电路制造用高端光刻胶系列产品

集成电路制造用高端光刻胶系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子光刻系列产品。包括 I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 干法、浸没式光刻胶系列产品及部分配套材料，主要用于逻辑、模拟和存储芯片生产制造。

（4）晶圆制造用化学机械研磨液

公司化学机械研磨液主要包括适用于浅槽隔离研磨液（STI Slurry）、金属钨研磨液（W Slurry）、金属铜研磨液（Cu Slurry）、硅氧化层研磨液（Oxide Slurry）、多晶硅层研磨液（Poly Slurry）等系列产品，研磨液产品可覆盖 14nm 及以上技术节点。

（5）晶圆制造用蚀刻液系列产品

晶圆制造用蚀刻液系列产品为公司面向存储芯片制造领域开发的电子蚀刻系列产品。主要包括用于 3D NAND/DRAM 存储器芯片制造的氮化硅/钛等蚀刻系列产品。

（6）半导体封装用电子化学材料

半导体封装用电子化学材料为用于半导体引线脚表面镀锡的化学材料及其配套电镀前处理、后处理化学材料，是公司面向传统封装领域开发的第一代电子电镀与电子清洗产品，包括无铅纯锡电镀液及添加剂、去毛刺溶液等。

（7）配套设备产品

配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。

（8）氟碳涂料产品系列

环保、功能性氟碳涂料包括：PVDF 氟碳粉末涂料、氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、超细耐候粉末涂料等。

（2）主要经营模式

1、研发模式

公司围绕自身的核心技术，面向集成电路产业当前和未来需求，以自主研发、自主创新为主，开展集成电路制造用关键工艺材料的研发和产业化。始终坚持以技术主导为核心，持续研发创新，积极融入国家创新体系。通过自主评估并结合国家科技重大专项的需求设立研发项目，开展产品开发、应用技术开发和生产工艺开发。同时与客户保持密切合作，针对性研发满足客户需求的产品，为其开发创新性的解决方案。通过对产品性能的不断优化及应用和生产工艺的提升，持续满足客户的需求。

2、采购模式

公司根据 ISO 质量体系要求，制定了《采购控制程序》，《采购流程》《供应商管理流程》做到规范化，系统化的执行各项采购工作。

a. 一般材料需求部门根据计划或者实际情况提交采购申请，实行采买；

b. 原材料采购，由需求部门提出材料需求，由质量部，技术中心共同评估材料的指标性能，招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应；

c. 固定资产和工程类采购，由相关部门参与评审，招标后按合同约定开展。

3、生产模式

公司采用以销定产的方式确定生产量。计划部每月月初根据市场部统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划，生产部合理安排实施当月生产。每周生产部和计划部还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，在满足客户的产品需求的同时提高产品周转率。

4、销售模式

公司采用的是直销模式。公司在半导体材料领域深耕二十多年，积累了良好的客户资源，并和其中的一些客户形成了战略合作关系。公司市场部负责跟进、整理公司所属行业发展情况，制定公司市场战略规划，制定公司业务目标以及产品市场的开发和产品销售工作。公司市场人员直接与客户进行商务洽谈，达成初步交易意向，签订销售合同。市场部销售人员负责与客户进行订单确认、评审、发货计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司持续为客户提供优质产品和服务的同时，通过挖掘已有客户新需求和不断开发新客户保证公司营业收入的持续增长。

5、服务模式

公司在集成电路制造用关键工艺材料及设备领域深耕细作，在为客户提供优质产品的同时，更能为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，快速响应客户需求，多方位整合公司资源，创新研发，为客户带来丰富和优质的服务方案，提升客户的产品竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	5,860,673,166.39	5,588,589,806.19	4.87%	5,620,352,673.68
归属于上市公司股东的净资产	4,536,694,935.49	4,188,533,225.02	8.31%	4,113,567,347.16
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,475,183,325.30	1,212,420,426.53	21.67%	1,195,686,064.34
归属于上市公司股东的净利润	175,708,529.19	166,840,625.59	5.32%	53,234,183.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,765,402.17	123,070,944.40	30.63%	111,611,267.84
经营活动产生的现金流量净额	224,741,098.52	151,385,721.60	48.46%	-38,609,613.85
基本每股收益（元/股）	0.5654	0.5389	4.92%	0.1707
稀释每股收益（元/股）	0.5654	0.5389	4.92%	0.1707
加权平均净资产收益率	4.21%	3.74%	0.47%	1.21%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,418,597.54	363,478,907.52	406,097,038.72	408,188,781.52
归属于上市公司股东的净利润	18,881,851.47	40,022,238.67	70,857,301.95	45,947,137.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,068,137.48	49,297,501.26	48,427,785.96	31,971,977.47
经营活动产生的现金流量净额	-15,822,300.96	48,896,392.61	15,653,686.73	176,013,320.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通	38,850	年度报告披露日前一个	38,282	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前一个	0	持有特别表决权股	0
--------	--------	------------	--------	----------	---	------------	---	----------	---

股东总数		月末普通股 股东总数		复的优先 股股东总 数		月末表决权 恢复的优先 股股东总数		份的股东 总数（如 有）	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00	不适用	0.00			
上海新晖资产 管理有限公司	境内非国有 法人	12.10%	37,933,276.00	0.00	质押	3,130,000.00			
上海新科投资 有限公司	境内非国有 法人	7.27%	22,788,086.00	0.00	质押	2,000,000.00			
孙慧明	境内自然人	3.32%	10,409,938.00	0.00	不适用	0.00			
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	2.30%	7,216,290.00	0.00	不适用	0.00			
金叶飞	境内自然人	2.11%	6,605,661.00	0.00	不适用	0.00			
杨燕灵	境内自然人	1.26%	3,954,600.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行 股份有限公司 一诺安成长混 合型证券投资 基金	境内非国有 法人	1.17%	3,659,200.00	0.00	不适用	0.00			
金叶玲	境内自然人	0.96%	2,999,190.00	0.00	不适用	0.00			
国泰君安证券 股份有限公司 一国联安中证 全指半导体产 品与设备交易 型开放式指数 证券投资基金	境内非国有 法人	0.79%	2,463,017.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行 动的说明		股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联股东，属于一 致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
上海新晖 资产管理 有限公司	35,698,176.00	11.39%	2,235,100.00	0.71%	37,933,276.00	12.10%	0.00	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

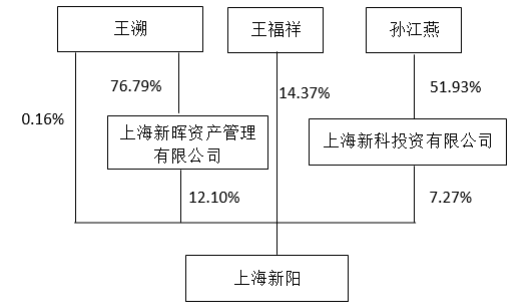
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

2024 年度，在全球经济复苏动能趋缓、地缘政治博弈加剧的复杂背景下，公司在董事会的战略引领与经营管理团队的高效管理下，聚焦主业，积极谋划部署各项工作，使公司整体运营水平进一步提高。在业务拓展上，公司充分发挥自身在技术开发、产品与客户服务方面的核心优势，围绕五大核心技术与产品，持续创新提升产品性能，积极落实市场开拓计划，围绕客户需求，深化客户合作，在研发、生产、销售和服务等方面都取得了显著成绩，进一步提升了公司在半导体材料领域的市场地位。

报告期内，公司实现营业收入 14.75 亿元，较去年同期增长 21.67%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比增长 5.32%，扣除非经常性损益后净利润为 1.61 亿元，同比增长 30.63%。公司半导体行业实现营业收入 10.35 亿元，同比增长 34.78%，主要是公司半导体业务板块新产品技术优势逐步凸显，类型不断丰富，重点项目市场开发进展顺利，取得客户订单数量持续增加。报告期内，公司晶圆制造用关键工艺材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额快速增长，集成电路制造用清洗、蚀刻系列产品在客户端进展顺利，销售不断攀升。涂料板块业务，建筑行业市场复苏缓慢，但受涂料产品售价下降等不利因素影响，2024 年实现营业收入 4.40 亿元，较去年同期略有下降。面对市场的挑战与压力，公司子公司积极应对，顺应时势调整运营管理策略，不断优化运营成本结构，净利润同比实现增长。

1、坚守创新之路，优势日渐凸显

公司坚定不移地贯彻执行以技术为主导发展战略，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。报告期内，面对产业快速发展及下游客户的迭代需求，公司围绕电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨、电子蚀刻五大核心技术，持续加大研发投入，创新产品技术，为客户提供整

体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 2.2 亿元，占本期营业收入的比重为 14.92%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程湿法蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目。

在集成电路制造及先进封装材料领域，公司自主开发的用于芯片铜互连的电镀系列产品——大马士革工艺材料、硅通孔工艺（TSV）材料广泛应用，来实现金属之间的互连。近年来随着高性能计算、AI 技术的快速发展，先进封装技术的需求快速增长，TSV 技术作为先进封装的核心工艺，通过与 2.5D/3D 封装、异构集成等技术的深度融合，成为推动芯片性能与集成度跃升的关键路径。经过多年的开发创新与技术储备，公司研发并量产的适用于 TSV 工艺的铜互连电镀添加剂，已经实现高效、均匀及结晶良好的 3D-TSV 中的微孔电镀填充，最高深宽比可达 20:1，处于国际领先水平。随着先进封装工艺技术的日趋成熟，公司与客户联动的紧密度加深，公司电镀液及其添加剂相关产品销售规模将持续快速提升。报告期内公司电镀液及添加剂系列产品销售额与去年同期相比增长超 50%，其中先进封装用电镀材料同比增长 116%。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售规模不断扩大，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。其中，铝互连干法蚀刻后清洗液长期受制于国外唯一原材料供应商限制，面对先进制程所需的配套材料亦需国产化的现状，公司自主研发攻关的防“卡脖子”的关键原材料项目——非羟胺清洗液项目，完成产品技术不断地迭代升级，在国内主流晶圆制造客户端通过验证并实现销售，该项目产品的清洗能力不断提升，市场份额逐步增加。公司凭借先进的技术优势及市场服务，晶圆制造用铜/铝制程清洗系列产品报告期内销售额快速增加，同比增长 47%，持续巩固了公司晶圆清洗系列产品市场地位。

蚀刻液是晶圆制造过程中的关键工艺化学材料，用于在晶圆加工过程中选择性去除特定材料（如硅、二氧化硅、金属等），以形成电路图案，尤其在复杂图形加工和特定材料处理方面具有不可替代的作用。公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品，自 2018 年立项以来历经三年技术攻关，实现四代技术产品的开发及迭代升级，可满足最大纵深比 1:200 的复杂图形的高精度蚀刻，达到蚀刻后图形的均匀性和平整性要求。目前公司已有三代技术产品实现规模化市场销售，开发出的适用于全世界最高水准的 3D NAND 存储芯片的高选择比氮化硅蚀刻液，选择性蚀刻速率最高可达 2000:1，报告期内蚀刻液市场应用规模进一步扩大，销售额持续增长。针对半导体产业快速更新迭代的需求，公司研发团队持续纵深开发，做好前瞻性的材料研究和技术储备，针对 3D NAND、DRAM 存储工艺需求的蚀刻类配方型化学品技术积极布局重点开发，目前两类蚀刻技术与产品已达到国际领先技术水平，在 3D 存储芯片制造工艺中已占有举足轻重的地位。公司蚀刻类产品的技术及服务优势不断凸显，品牌影响力不断提高。

光刻胶作为晶圆制造环节中的重要关键材料，长期以来被日本、欧美等海外企业所垄断。公司作为集成电路制造用关键工艺材料研发型企业，致力于推动高端光刻胶产品国产化进程，依托自身的技术实力和持续的研发投入，经过 8 年的开发布局，已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类光刻胶在内的完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，能为国内芯片企业提供多品类光刻胶产品，部分品类已实现产业化，少数品类关键光学数据处行业领先水平，公司已成为国内光刻胶供应链中重要一环。报告期内，公司 KrF 光刻胶已有多款产品实现批量化销售，光刻胶产

品整体销售规模持续增加，同比增长超 100%，其中，ArF 浸没式光刻胶已取得销售订单，迈出了实现产业化的第一步，为国产高端光刻胶早日实现国产化提供了坚实的支撑。

在集成电路用化学机械研磨液技术与产品开发方面，基础研发、生产工艺、分析开发、技术应用等方面工作进展迅速，成熟的 STI slurry、Poly slurry、W slurry 等系列产品在客户端测试验证已完成，可覆盖 14nm 及以上技术节点，并进入批量化生产阶段。其中，先进制程 Poly slurry 产品已进入国内主流晶圆公司产线，产品性能优越，打破了国外对该产品的垄断，为研磨液产品的量产销售及未来发展奠定基础。

公司多年来始终坚持自主创新，注重研发技术积累与市场开拓能力提升，围绕公司五大核心技术持续创新，通过与产业链上下游协同发展，不断攻克被“卡脖子”关键工艺材料产品技术难关，已实现从“集成电路关键工艺材料行业跟跑者变成局部领跑者”，公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力不断提升。

2、半导体业务扩张，助国产力量崛起

半导体行业的发展对科技和经济发展具有重要意义。随着整个半导体产业的持续增长以及中国大陆新建代工产能的不断增加，中国大陆半导体市场规模增速将会持续增加，叠加我国国产替代大潮，国内半导体材料市场必将迎来充满机遇的蓬勃发展期。面对行业需求的快速扩大，公司制定了中长期发展规划，持续聚焦“业务规模做大、技术能力做强、行业地位做高，成为半导体材料行业引领者”的发展战略。报告期内，公司布局建设的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求，2024 年全年公司化学品总产量超 2 万吨，相较去年同期增长了 37%，其中晶圆制造用化学材料产品产量占比超 80%。合肥新阳第二生产基地一期项目，报告期内各项认证工作紧密开展并顺利通过，规划设计的蚀刻液、清洗液、电镀液等各产线均顺利投产。

为了进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位，根据市场需求及公司发展战略，稳步推进合肥新阳第二生产基地建设项目与上海化学工业区一期项目建设，加大对晶圆制造用关键工艺材料产业化开发。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续加深，新产能的陆续建成投产，公司产能规模的不断释放，能够满足未来市场需求的增长，助推公司未来发展战略规划的逐步实现。

3、细化管理体系，践行半导体气息

2024 年是上海新阳成立 25 周年，是公司快速发展的新阶段。在这个全新的发展阶段，公司持续围绕技术主导、市场引领的发展战略，持续创新、创造，打造自身技术引领优势，赋能公司未来发展，成为半导体材料行业引领者。

2024 年全年公司持续推进“半导体气息”管理的落地，不断提高公司核心竞争力，提升公司风险应对能力。公司高度重视提升企业运营管理能力，不断优化完善管理体系，提升市场规划、供应链管理、质量管理、安全生产等方面运行水平。同时，逐步加强信息安全管控、建设常态化管控信息系统等工作，为公司数据资产安全、业财融合转型筑牢数字化防线，满足未来集团战略管理需要，支持集团可持续、高质量发展。

随着业务规模的不断扩大，技术开发难度不断提升，公司高度重视人才储备和团队专业能力培养和提升工作。公司结合行业需求及发展规划，组建高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，完善公司各层级人才梯队建设工作，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动倾听员工心声；通过开展质量知识竞赛、邀请客户现场培训交流等方式，持续提升全员半导体气息意识；通过组织“重温英雄志”徐州团建、“我和新阳”25 周年主题征文等活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工工作和生活热情，提高员工企业文化认同感。

2024 年公司持续实施股权激励及员工持股的一揽子计划，践行薪酬证券化长效激励机制，实施了芯征途（三期）员工持股计划及 2024 年股票增值权激励计划，持续与员工共享公司发展红利，提升员工在企幸福指数。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。通过各项“深化半导体气息”工作的不断开展，目标是增强公司的生存成长能力和行业影响力，提升每一位员工的个人品格魅力和职业素养，最终实现企业竞争力的全面提升。

4、参与产业投资，助力产业发展

长期以来，公司专注于集成电路关键工艺材料领域的深耕细作，精心策划投资布局，致力于推动集成电路全产业链中设备制造及核心原材料供应企业的成长壮大，为整个产业链的升级与繁荣贡献力量。

报告期内，公司参与了由长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司持有 90% 股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司发起设立的合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙），助力国家半导体存储产业链的快速发展。同时，为实现我国半导体领域关键工艺材料产业链早日自主可控并规模化量产，推动公司光刻胶产品业务的纵深发展，公司以增资方式投资浙江新盈电子材料有限公司。

公司在不断精炼和完善集成电路产业链布局的过程中，积极为产业链上的尖端技术、卓越产品和优秀团队注入活力，旨在与公司主营业务产生强大的协同作用，拓展并增强产品的市场竞争力，进而巩固和提升公司在行业内的地位与影响力。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2025 年 4 月 16 日